

AM2520SYC09

SUPER BRIGHT YELLOW

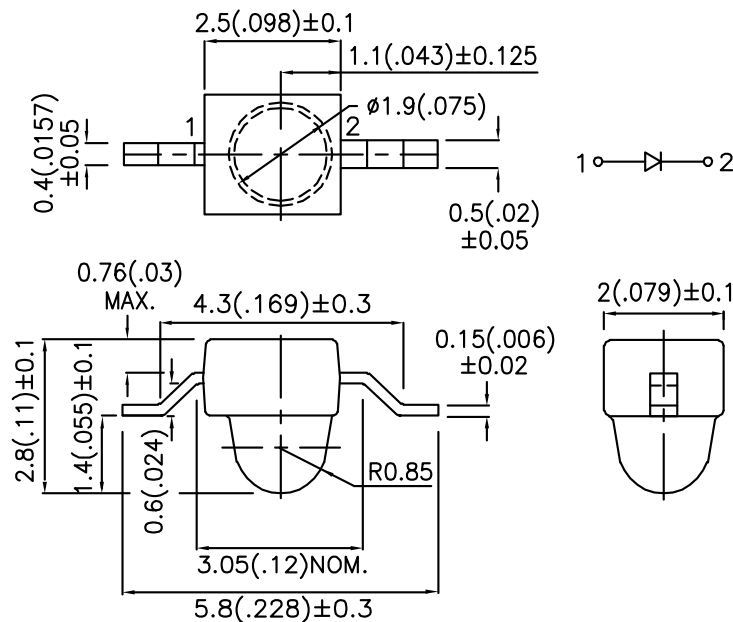
Features

- SUBMINIATURE PACKAGE.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- Z-BEND LEAD.
- LONG LIFE - SOLID STATE RELIABILITY.
- LOW PACKAGE PROFILE.
- PACKAGE : 1000PCS / REEL.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The Super Bright Yellow device is made with DH InGaAlP (on GaAs substrate) light emitting diode chip.

Package Dimensions



Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ " unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2θ1/2
AM2520SYC09	SUPER BRIGHT YELLOW (InGaAlP)	WATER CLEAR	110	700	20°

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

Electrical / Optical Characteristics at T_A=25°C

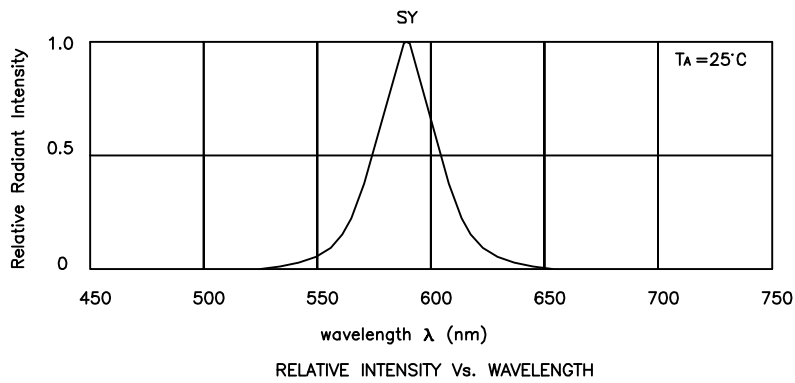
Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Super Bright Yellow	590		nm	I _F =20mA
λ _D	Dominant Wavelength	Super Bright Yellow	588		nm	I _F =20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Super Bright Yellow	28		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Super Bright Yellow	25		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	Super Bright Yellow	2.0	2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Super Bright Yellow		10	uA	V _R = 5V

Absolute Maximum Ratings at T_A=25°C

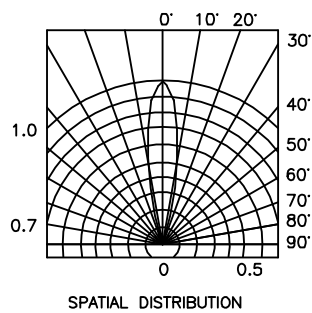
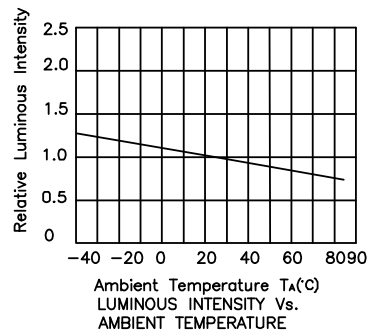
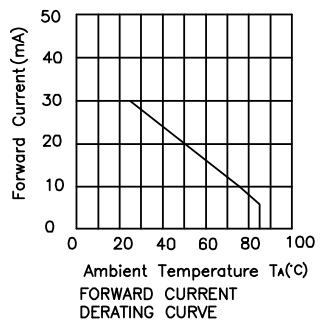
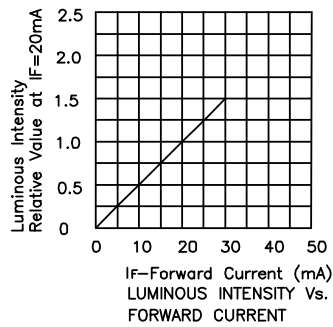
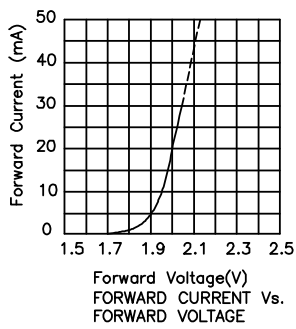
Parameter	Super Bright Yellow	Units
Power dissipation	125	mW
Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	150	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating / Storage Temperature	-40°C To +85°C	

Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

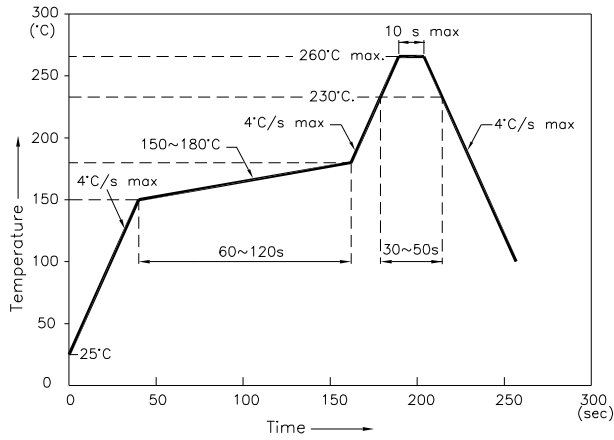


Super Bright Yellow AM2520SYC09



AM2520SYC09

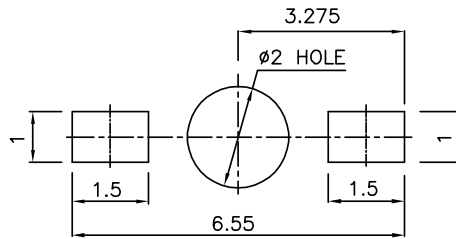
Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.



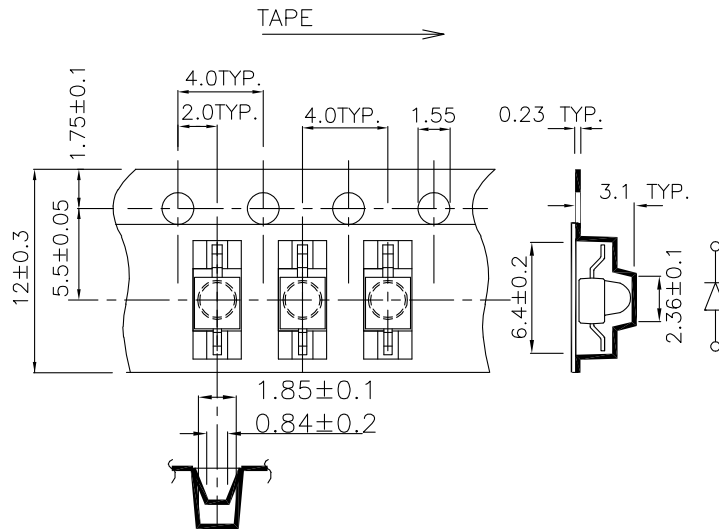
NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

Recommended Soldering Pattern (Units : mm)



Tape Specifications (Units : mm)



Remarks:

If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage, luminous intensity, or wavelength), the typical accuracy of the sorting process is as follows:

1. Wavelength: +/-1nm
2. Luminous Intensity: +/-15%
3. Forward Voltage: +/-0.1V

Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9